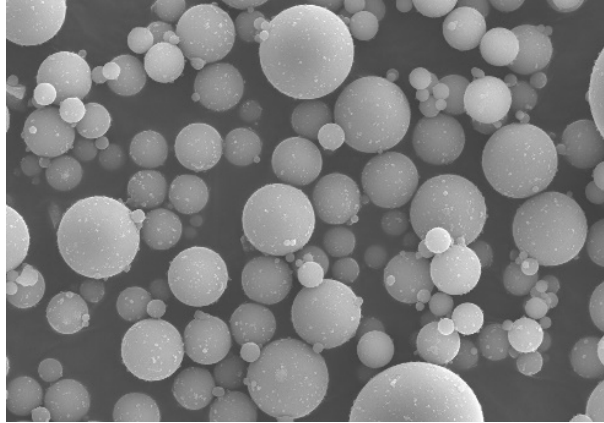


球状シリカ シンガポール製造設備の増強を決定
～環境・エネルギー分野のさらなる成長に向けて製造能力を約3割増強～



<球状シリカ（拡大写真）>

デンカ株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：今井 俊夫）は環境・エネルギー分野のさらなる成長を目的として、シンガポールの連結子会社である Denka Advantech Pte. Ltd. (DAPL) のトラス工場に球状シリカの戦略投資を行い、グループ全体での生産能力を約3割増強することを決定しました。

当社の球状シリカは高絶縁性、低熱膨張性を活かして半導体封止材料や半導体パッケージ基板、各種樹脂への充填材として使用されており、高速・大容量データ通信（5G）・自動車の電動化（xEV）により、近年需要が増加しています。

当社はこの球状シリカで世界シェア約3割を占めるトップメーカーで、大牟田工場（福岡県大牟田市）およびシンガポールの2拠点体制で生産しておりますが、今後の旺盛な需要に対応するため、今般シンガポールの製造設備を増強し中長期的な安定供給体制を構築いたします。

当社は昨年10月に大牟田工場において、球状シリカを含む「次世代の高機能球状フィラー製造設備の増強」を決定し、様々な先端・高信頼性分野に対応可能な品揃えを可能とする戦略投資をおこないます。今回、大牟田に加えてシンガポールへの戦略投資を通じて2拠点生産体制のBCP対応をさらに強化すると共に、先端・高信頼性分野への事業展開を加速いたします。

当社は中期経営計画「Denka Value-Up」において、xEV・5Gを中心とした環境・エネルギー分野を重点分野の1つと位置づけています。

今後もSDGsを羅針盤に、誰よりも上手にできる仕事で全ての人がより良く生きる世界をつくる、社会にとってかけがえのない企業を目指してまいります。

以上

1. 投資概要

- ・投資拠点：シンガポール トアス工場
(Denka Advantech Pte. Ltd. Tuas Plant, 11A Tuas Avenue 20, Singapore 638823)
- ・投資内容：球状シリカの製造設備の増設
- ・竣工時期：2024年（予定）

※本件による2022年度当社連結業績への影響はありません。

2. 球状シリカ

原料を当社独自の高温溶融技術により球状化した高球形シリカであり、電気絶縁性、低熱膨張性に優れています。本製品は多様な粒度分布に対応しており、半導体封止材、半導体パッケージ基板、各種樹脂への充填材など、多岐用途に対応可能です。

【報道関係者からのお問い合わせ先】

コーポレートコミュニケーション部 電話：03-5290-5511

【お客様からのお問い合わせ先】

電子・先端プロダクツ部門 先端機能材料部 電話：03-5290-5539